

Anwenderhinweise für Lote

Application Note for Alloys

BALVER ZINN[®]
COBAR[®]

Datum / Date: 2024.02.16

Sprache / Language: Multilingual

Revision / Revision: 24.1



Wareneingang und Lagerung	Receiving and storage
Lote unterliegen nicht der Mindesthaltbarkeit, sollten dennoch trocken und bei Raumtemperatur gelagert werden. Kunststoffspulen von Massivdrähten sind empfindlich und sollten nicht geworfen werden. Produktkennzeichnungen und Chargennummer nicht entfernen oder unkenntlich machen	Alloys are not shelf-life items but should be stored dry and at room temperature. Plastic spools of solid wires are sensitive and should not be thrown. Do not remove or make illegible product labels and batch numbers.
<u>BITTE NICHT:</u>	<u>DO NOT:</u>
- X Feuchtigkeit aussetzen - X Kennzeichnungen entfernen / überkleben - X Spulen nicht werfen	- X Expose to humidity - X Remove / stick over markings - X Do not throw spools
Handhabung	Handling
Barren sollten mit Handschuhen gehandhabt werden, um Verletzungen vorzubeugen. Barren- und Pellet Kartons sind schwer, mit Vorsicht aufnehmen.	Bars should be handled with gloves to prevent injury. Ingot and pellet boxes are heavy, pick up with care.
<u>BITTE NICHT:</u>	<u>DO NOT:</u>
- X mit anderen Lotzusammensetzungen mischen - X Ohne Schutzausrüstung arbeiten	- X mix the flux with other alloy compositions - X Work without protective equipment
Erstbefüllung von Maschinentiegeln	Initial filling of machine crucibles
Bei der Erstbefüllung von Maschinentiegeln sollten immer die Grundlegierung eingesetzt werden, da die Eigenschaften des Lotes sonst nicht gegeben sind. Erstbefüllungen durch „Nachsatzlote“ können zu Problemen und übermäßiger Ablegierung von Kupfer führen. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie gerne. In Abhängigkeit der Maschinentyp und Konstellation bietet wir speziell abgestimmte Lotsysteme an. Lotbadanalysen sollten regelmäßig durchgeführt werden, um Verunreinigungen des Lot Bades rechtzeitig erkennen zu können.	The base alloy should always be used when filling machine crucibles (solder pots) for the first time, as the properties of the solder are otherwise not given. First filling with “refill alloy” can lead to problems and excessive copper dissolution. Our application engineers will be happy to advise you. Depending on the machine type and constellation, we offer special alloy systems. Solder bath analyses should be performed on regular base to avoid contamination.

Anwenderhinweise für Lote

Application Note for Alloys

BALVER ZINN[®]
COBAR[®]

<u>BITTE NICHT:</u>	<u>DO NOT:</u>
X Mit Nachsatzlot befüllen	X Use refill alloy for the first filling
Nachfüllen von Maschinentiegeln	Preheating
Achtung: Verbrennungsgefahr durch heißes Lot. Bei manueller Befüllung von flüssigen Lotbädern entsprechende Schutzausrüstung tragen. Lotbadverunreinigungen durch falsche Lotzugaben vermeiden. Barren, Pellets oder Stangen langsam zugeben, um einen starken Temperaturabfall im Tiegel zu vermeiden. Es kann sonst zu Inhomogenitäten in der Zusammensetzung kommen. Über die Lotbadanalyse das richtige Nachsatzlot wählen. Wir verweisen auf das zugehörige Produktdatenblatt (PDS)	Caution: Danger of burns by hot solder. Wear appropriate protective equipment when refill the liquid solder baths by hand Avoid solder bath contamination due to incorrect solder additions. Add ingots, pellets, or bars slowly to avoid a temperature drop down in the crucible. Otherwise, inhomogeneities in the composition may occur. Select the correct additive solder via the solder bath analysis. Please refer to the corresponding product data sheet (PDS).
<u>BITTE NICHT:</u>	<u>DO NOT:</u>
X zu schnelles nachfüllen, kann zu Inhomogenität führen	X Refill the solder pot to fast might lead to inhomogeneities
X Falsche Materialien zugeben	X Use incorrect solder additions
Löten	Soldering
Anhang A: Lotbadtemperaturen Höhere Lotbadtemperaturen sind prozessbedingt möglich und für das Lot unkritisch. Achtung: für die Temperaturbelastung der Bauteile ist nicht die Löttemperatur ausschlaggebend, sondern die an den Bauteilen gemessene Temperatur! Befinden sich die wichtigsten Legierungsbestandteile außerhalb der kritischen Werte, so kann das zu vermehrten Lötproblemen führen (Brückenbildung, Durchstieg, usw.).	Appendix A: Solder bath temperatures Depending on the process higher solder bath temperatures might be used selected and are not critical for the solder. Attention: Please note that it is not the solder temperature but the temperature measured on the components, which determines the level of thermal stress subjected to the component. If the most important alloy components are out of critical values, this can lead to increased soldering problems (bridging, trough hole filling, etc.).
Krätze Bildung / Reinigung	Dross formation / Cleaning
Im Stickstofffreien Betrieb ist Oxydation und die damit umhergehende Krätze Bildung unvermeidbar. Durch speziell abgestimmte Legierungssysteme bieten wir für alle Prozesse die optimal angepasste Lösung an. Fällt dennoch Krätze an, sollte diese regelmäßig entnommen und gesammelt werden.	Soldering under ambient conditions causes oxidation and dross formation. We offer the optimum solution for all processes due to special alloy systems. If dross nevertheless accumulates, it should be removed and collected regularly.

Anwenderhinweise für Lote

Application Note for Alloys

BALVER ZINN[®]
COBAR[®]

BITTE NICHT:

X Lotbadoberfläche zu oft reinigen

DO NOT:

X Clean the solder bath surface too often

Appendix A: Solder bath temperatures

Zusammensetzung / Composition	Prozess / Process	T min	T max
Sn63Pb37	Wellenlöten / Wave soldering	240°C	255°C
	Selektivlöten / Selective soldering	255°C	270°C
	Tauchverzinne / Dipping application	240°C	300°C
SN100C Serie	Wellenlöten / Wave soldering	260°C	270°C
	Selektivlöten / Selective soldering	270°C	320°C
	Tauchverzinne / Dipping application	260°C	350°C
SN100CL Serie	Hot Air Levelling (HAL)	260°C	280°C
SN100CV	Wellenlöten / Wave soldering	260°C	270°C
	Selektivlöten / Selective soldering	270°C	320°C
	Tauchverzinne / Dipping application	260°C	350°C
SN97C, SN96C, SCAN-Ge071, SCA0703	Wellenlöten / Wave soldering	260°C	270°C
	Selektivlöten / Selective soldering	270°C	320°C
	Tauchverzinne / Dipping application	260°C	290°C
SN100C3, SN100C4, SnCu3	Tauchverzinne / Dipping application	350°C	540°C
Pb96Sn2Ag2	Tauchverzinne / Dipping application	400°C	550°C
Bi57Sn43	Wellen – Selektivlöten / Wave-Selective soldering	180°C	200°C

Produktreste / Verwertung

Produktreste und / oder Reaktionsprodukte sind Wertstoffe und sollten einer hochwertigen Verwertung zugeführt werden.

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen sollten einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Ursprungsinhalt (Stoff) zu behandeln.
Dieses kann gem. den nationalen Rechtsvorschriften bei autorisierten Fachbetrieben oder im Rahmen der freiwilligen Rücknahme (§26 KrWG Abs. 2) durch BALVER ZINN erfolgen.

Endgeräte sind getrennt vom Hausmüll bei einer offiziellen Sammelstelle dem Recyclingkreislauf zu zuführen.

Verweis auf die Endproduktspezifischen Entsorgungsverordnungen (WEEE, Altautoverordnung...)

Product leftover / Recovery

Product residues and / or reaction products are recyclable materials and should be sent for high-quality recycling.

Non-contaminated and empty packaging should be recycled.

Contaminated packaging must be treated in the same way as the original content (substance).
In accordance with national legislation, this can be done by authorized specialist companies or by BALVER ZINN as part of the voluntary take-back scheme (§26 KrWG para. 2).

End devices must be disposed separately from domestic waste at an official collection point for recycling.

Reference to the end product-specific disposal regulations (WEEE, end-of-life vehicle regulations, etc.)

Please refer to the associated safety data sheet (SDS).

Anwenderhinweise für Lote

Application Note for Alloys

BALVER ZINN[®]
COBAR[®]

Wir verweisen auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Sprechen Sie uns an.

Please contact us.